

出展のご案内

部品・部材ゾーン

Booth No. **2221**



パッケージ基板研削

～半導体及び先端パッケージ技術の進化への対応～

WLP/PLP研削におけるCu+モールド樹脂加工
及び複合材平坦化技術により、IoT社会の実現へ貢献します

加工実例

積層技術に対応した、パッケージ材料研削
様々な用途のパッケージ材料研削
パッケージ材料研削
様々な樹脂材料

5G関連

LT/LN等の電子部品の
研削装置

パッケージ基板薄化を メインとした 総合砥粒加工を提案します

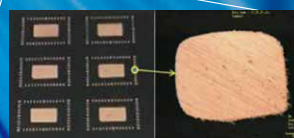
「技術の岡本」をスローガンに、
総合砥粒加工機メーカーとして
5つのご提案を致します。



Before Grinding



After Grinding



Cu/Mold Grinding with HPD



Si/Mold Grinding with HPD

3DIC加工

TSV研削におけるCu+Si等複合材加工
及びTTV自動補正を含めた新プロセス

bumpsウエーハの薄化

BGテープの高精度研削技術

次世代 パワーデバイス用材料

SiC・GaN等への低ダメージ、
高速加工技術と装置

Okamoto

株式会社岡本工作機械製作所

ナノプロセスグループ

〒379-0135 群馬県安中市郷原2993 TEL 027-385-6211 FAX 027-385-1144

<https://www.okamoto.co.jp>